

Preliminary



SF2251E

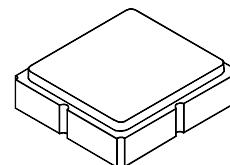
**1600 MHz
SAW Filter**

- Low-loss RF SAW Filter
- 3.0 x 3.0 x 1.4 mm Surface-mount Case
- No Matching Required for 50Ω Operation
- Complies with Directive 2002/95/EC (RoHS)



Absolute Maximum Ratings

Rating	Value	Units
Incident Power in Passband	+10	dBm
DC Voltage on any Non-ground Terminal	3	VDC
Operating Temperature Range	-55 to +85	°C
Storage Temperature Range in Tape and Reel	-55 to +95	°C
Maximum Soldering Profile, 5 cycles/10 seconds maximum	265	°C



SM3030-6

Electrical Characteristics

Characteristic	Sym	Notes	Min	Typ	Max	Units
Center Frequency	f_c			1600		MHz
Insertion Loss, 1580 to 1620 MHz	IL			3.15	5.00	dB
1500 MHz Attenuation Referenced to 0 dB			45	64		dB
1700 MHz Attenuation Referenced to 0 dB			40	47		dB
Terminating Source Impedance	Z_s			50		Ω
Terminating Load Impedance	Z_L			50		Ω
Input/Output Impedance Match	No matching network required for 50 ohm source/load					
Case Style	SM3030-6					
Lid Symbolization	992					

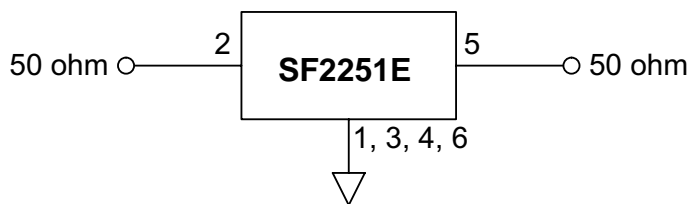


CAUTION: Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.

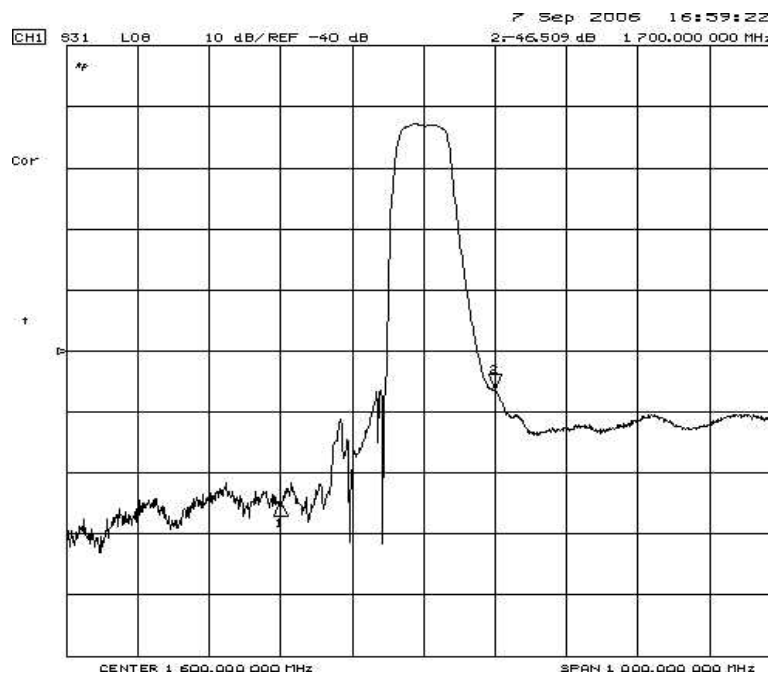
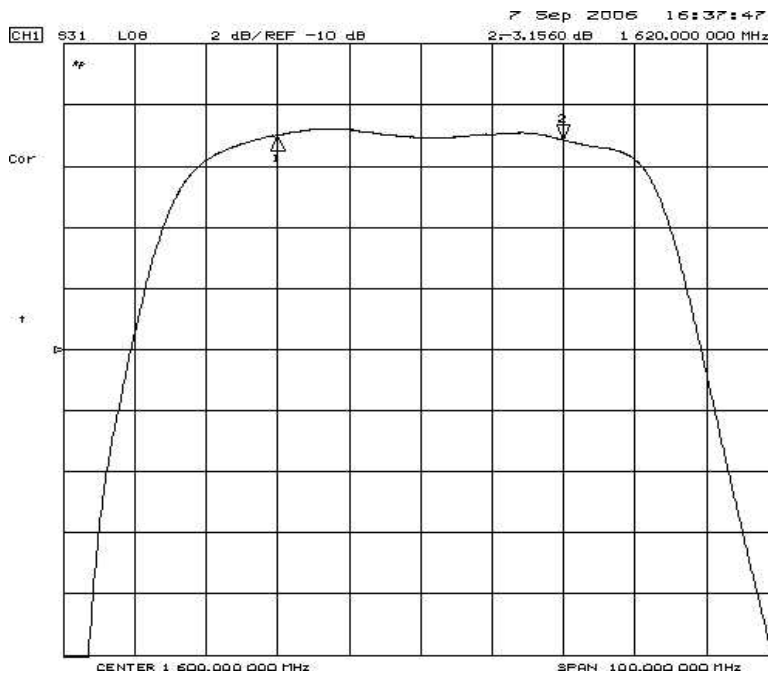
Notes:

1. US and international patents may apply.
2. RFM, stylized RFM logo, and RF Monolithics, Inc. are registered trademarks of RF Monolithics, Inc.

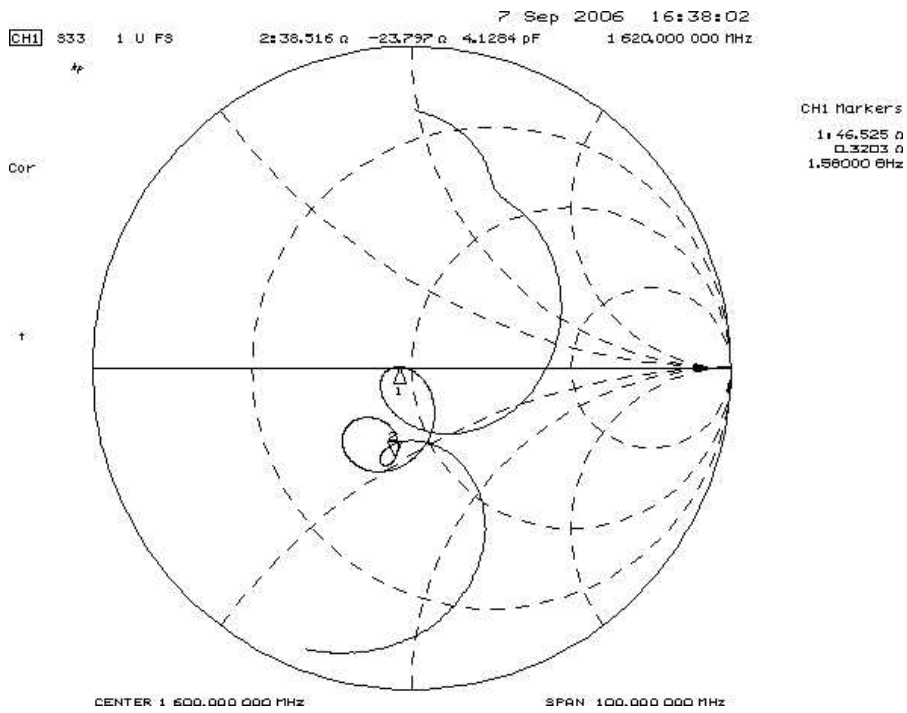
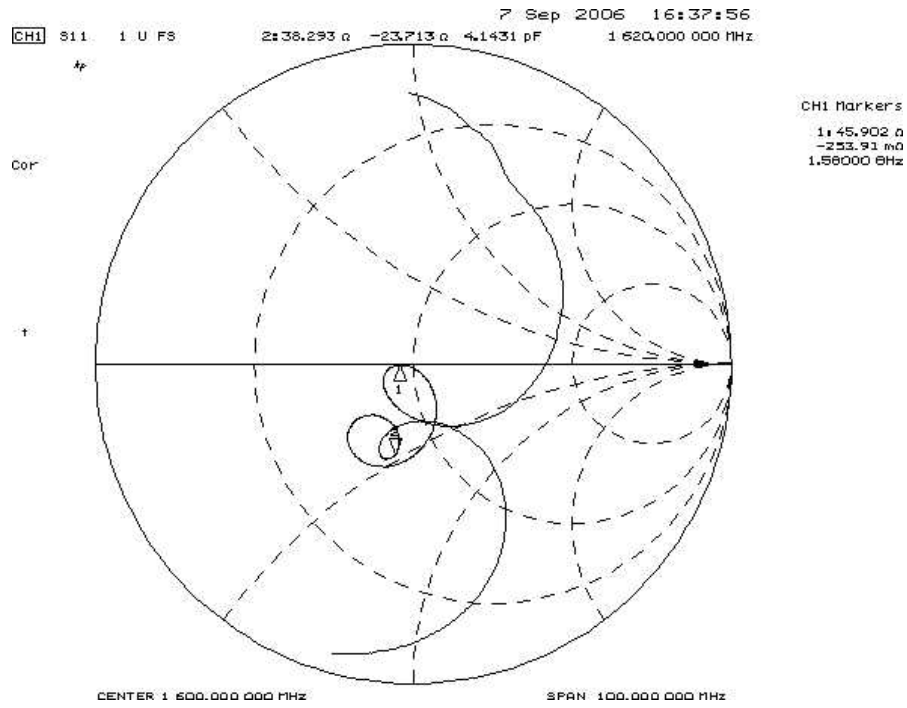
Matching Circuit



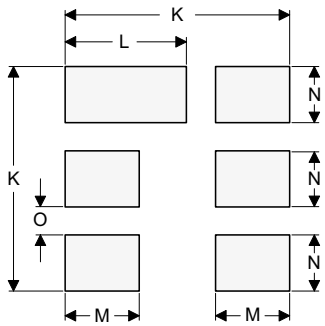
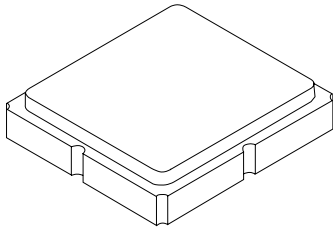
Frequency Response Plots



Input/Output Impedance Plots



6-Terminal Ceramic Surface-Mount Case 3.0 X 3.0 mm Nominal Footprint



PCB Footprint Top View

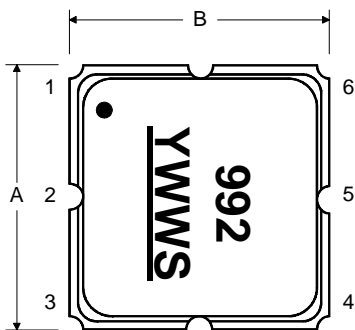
Case and PCB Footprint Dimensions

Dimension	mm			Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	2.87	3.00	3.13	0.113	0.118	0.123
B	2.87	3.00	3.13	0.113	0.118	0.123
C	1.12	1.25	1.38	0.044	0.049	0.054
D	0.77	0.90	1.03	0.030	0.035	0.040
E	2.67	2.80	2.93	0.105	0.110	0.115
F	1.47	1.60	1.73	0.058	0.063	0.068
G	0.72	0.85	0.98	0.028	0.033	0.038
H	1.37	1.50	1.63	0.054	0.059	0.064
I	0.47	0.60	0.73	0.019	0.024	0.029
J	1.17	1.30	1.43	0.046	0.051	0.056
K		3.20			0.126	
L		1.70			0.067	
M		1.05			0.041	
N		0.81			0.032	
O		0.38			0.015	

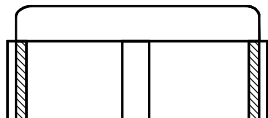
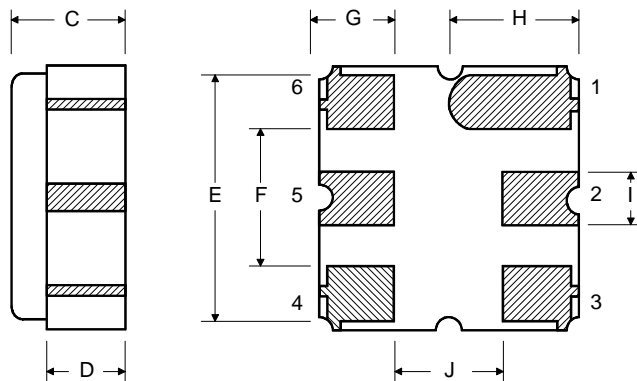
Case Materials

Materials	
Solder Pad Plating	0.3 to 1.0 μm Gold over 1.27 to 8.89 μm Nickel
Lid Plating	2.0 to 3.0 μm Nickel
Body	Al_2O_3 Ceramic
Pb Free	

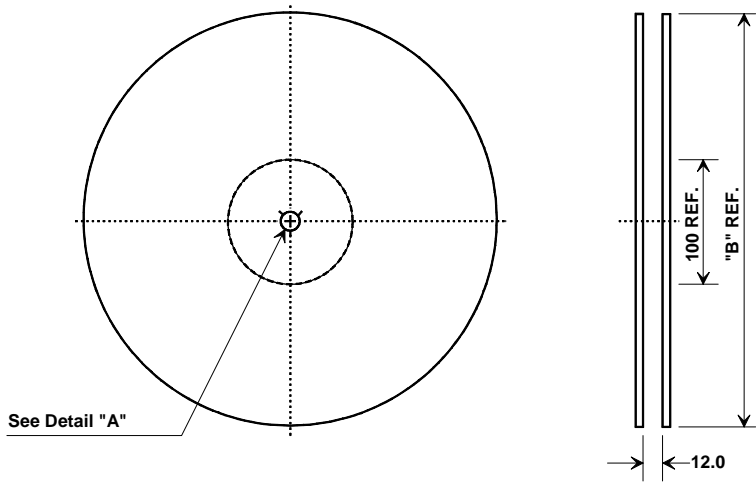
TOP VIEW



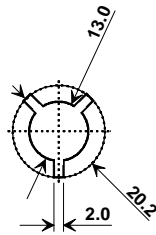
BOTTOM VIEW



Tape and Reel Specifications

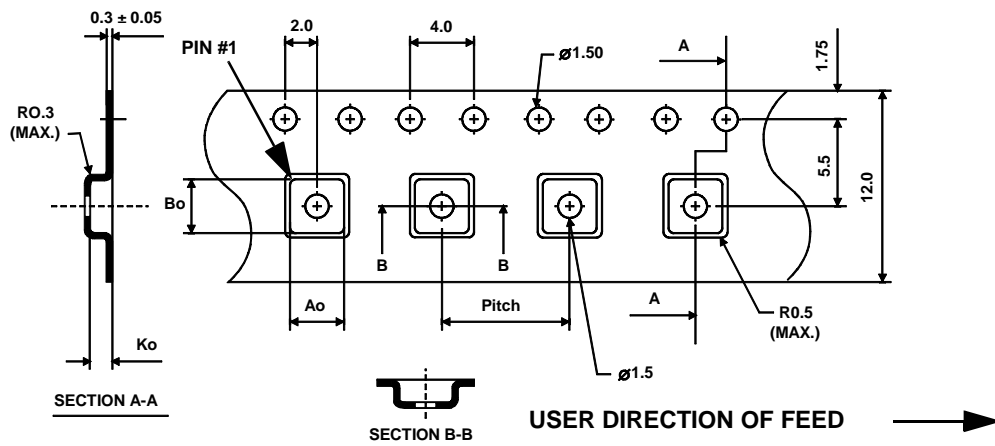


"B"		Quantity Per Reel
Inches	millimeters	
7	178	500
13	330	3000



COMPONENT ORIENTATION and DIMENSIONS

Carrier Tape Dimensions	
Ao	3.35 mm
Bo	3.35 mm
Ko	1.40 mm
Pitch	8.0 mm
W	12.0 mm



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9